

国際交流  
企画

同志社大学留学生課 SIED



Let's remake snack packages!

# お菓子パッケージ グッズを作ろう!!

日本のお菓子のパッケージにはかわいいデザインのものがたくさんあります! 本イベントでは、そんな日本でお馴染みのパッケージを使い、ポーチとリングノートのリメイク雑貨を作ります! みんなで楽しく作りながら、国際交流しましょう~♪

Japan has many snacks with pretty packaging bags! In this event, you will make original items with them such as pouch and notebook.  
Let's have fun with it!



2021/6/23(水, Wed)  
4限, 4th period

【場所 Place】今出川校地 国際交流ラウンジ(扶桑館2F) International Community Lounge(Fusokan2F, Imadegawa Campus)

【参加費 Fee】100円 100Yen

【定員 Capacity】本学学生10名 10 Doshisha students

※応募多数の場合は抽選となります Participants will be picked by lot

【申し込み方法 How to apply】

QRコードまたは、QRコード下のURLから応募フォームにアクセスし、ご応募ください

Go to the links below or scan the QR codes to apply via the Web form.

【申し込み締切 App. deadline】6/12(土/Sat)

<https://forms.office.com/r/c3dSJ5zqaE>

同志社大学国際センター留学生課SIED / SIED, Office of International Students

E-mail: [ji-sied@mail.doshisha.ac.jp](mailto:ji-sied@mail.doshisha.ac.jp) SIED Website: [http://ois.doshisha.ac.jp/international\\_exchange/sied.html](http://ois.doshisha.ac.jp/international_exchange/sied.html)

※個人情報は、本学の定める基本方針等に基づき適切に管理致します。 ※We manage personal information appropriately based on Doshisha's basic policy.

今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、イベントの開催中止あるいは延期の可能性あります。 It may be cancelled or postponed due to the spread of COVID-19 circumstances.

